

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 25 年 3 月 21 日 (2013.3.21)

【公開番号】特開 2012-33626 (P2012-33626A)

【公開日】平成 24 年 2 月 16 日 (2012.2.16)

【年通号数】公開・登録公報 2012-007

【出願番号】特願 2010-170807 (P2010-170807)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/00 (2006.01)

H 0 1 L 21/301 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/00 C

H 0 1 L 21/78 M

H 0 1 L 21/78 Q

【手続補正書】

【提出日】平成 25 年 1 月 31 日 (2013.1.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

被着体上にフリップチップ接続される半導体素子の裏面に配設されるフリップチップ型半導体裏面用フィルムであって、

接着剤層と、この接着剤層上に積層された保護層とを備え、

前記保護層は、金属で構成されているフリップチップ型半導体裏面用フィルム。

【請求項 2】

前記金属が、アルミニウム、アルマイト、ステンレス、鉄、チタン、スズ及び銅からなる群より選択される少なくとも 1 種である請求項 1 に記載のフリップチップ型半導体裏面用フィルム。

【請求項 3】

前記保護層の前記接着剤層側の表面に対して表面活性化処理が施されている請求項 1 又は 2 に記載のフリップチップ型半導体裏面用フィルム。

【請求項 4】

前記表面活性化処理が、プラズマ処理、オゾン水処理、紫外線オゾン処理及びイオンビーム処理からなる群より選択される少なくとも 1 種の処理である請求項 3 に記載のフリップチップ型半導体裏面用フィルム。

【請求項 5】

基材上に粘着剤層が積層されたダイシングテープと、

前記粘着剤層上に、前記保護層側を向けて積層された請求項 1 ~ 4 のいずれか 1 に記載のフリップチップ型半導体裏面用フィルムと

を備えるダイシングテープ一体型半導体裏面用フィルム。

【請求項 6】

請求項 5 に記載のダイシングテープ一体型半導体裏面用フィルムにおけるフリップチップ型半導体裏面用フィルム上に半導体ウェハを貼着する工程と、

前記半導体ウェハをダイシングして半導体素子を形成する工程と、

前記半導体素子を前記フリップチップ型半導体裏面用フィルムとともに、ダイシングテ

ープの粘着剤層から剥離する工程と、  
前記半導体素子における被着体との接続用部材にフラックスを付着させる工程と、  
前記半導体素子を前記被着体上にフリップチップ接続する工程と  
を具備する半導体装置の製造方法。